

Mirror Mezz连接器

Mirror Mezz系列扣板连接器不区分插头插座（公母同体），提供出色的信号完整性（SI）和数据传输速度，可满足电信、网络和其它高密度应用系统不断增长的数据传输需求，包括符合开放计算项目（OCP）的系统。

优点和特点

为下一代应用场合提供高速数据传输速率
连接器提供高达224Gbps的数据传输速率，能够支持人工智能（AI）和机器学习（ML）等高性能应用。

通过公母同体设计降低了应用成本
自配设计简化了物料清单（BOM）和库存管理，同时最大限度地减少了对工具的要求。

加快交货速度，优化产品组合
Mirror Mezz产品采用扁平球栅阵列（BGA）连接方式。

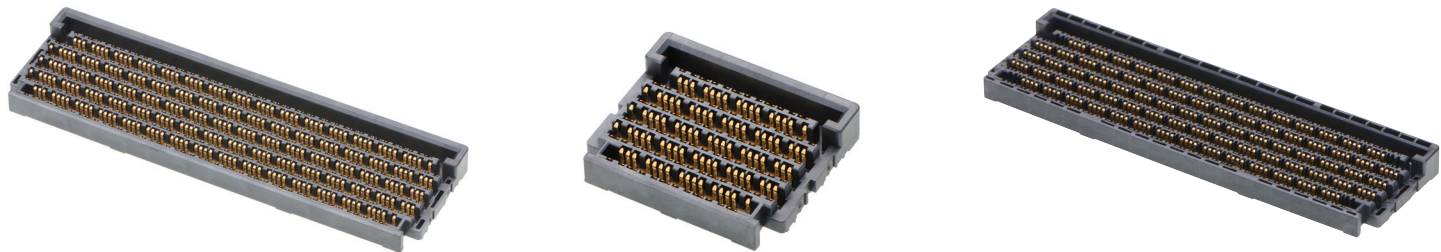
采用符合15x11 OCP标准的设计，增强了设计的灵活性
该连接器被OCP推荐用于15x11中间层板对板连接，确保OCP标准系统之间的互操作性。

速率	高达224Gbps（Mirror Mezz增强型） 高达112Gbps（Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro）
引脚数	多达270个差分线对（DP）
连接器高度	2.50或5.50毫米
堆叠高度	5.00、8.00或11.00毫米
标准	OCP 15x11（Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro）
工作温度	-40°C至+105摄氏度

通过最大限度利用电路板空间来缓解设计挑战
高密度连接器引脚矩阵包括多达270个差分线对。

在高度受限的应用中优化空间使用
高度为2.50和5.50毫米的连接器之间通过互配或自配，能够实现5.00、8.00或11.00毫米的超低和中等堆叠高度。

最大限度地增强高速性能和信号完整性
通过“无茬”接触界面与精确布局的宽接地引脚相结合，再融合经过电调整优化的信号接点，旨在增强信号完整性并促进电场平衡。



Mirror Mezz连接器

市场和应用场合

服务器和存储器

网络设备
存储系统
服务器机架
开放加速器基础设施（OAI）设备

电信

电信基础设施
网络设备

汽车

电控单元
域控制单元
分区控制单元



存储系统



网络设备



电控单元

参数规格

参考信息

包装：卷带
对配器件：2.50和5.50毫米高连接器可自配或互配
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤素：是

电气参数

电压（最大值）：29.9伏交流，有效值
电流（每个接点的最大电流）：Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro：1.0安培；Mirror Mezz Enhanced：0.75安培
低电平接触电阻：
最大30毫欧（初始值），最大10毫欧（增量）
绝缘耐压：500伏直流
绝缘电阻：1,000兆欧
阻抗：90欧姆

机械参数

间距：差分线对之间4.00毫米，行间1.50毫米
电路：多达270个差分线对
可插拔次数（最大值）：100次
对配力（每个引脚的最大值）：
Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro：0.35牛；
Mirror Mezz Enhanced：0.5牛
插配失准矫正能力：1.20毫米（Y轴）和1.00毫米（X轴）
平均拔脱力（最小值）：每个引脚0.045牛

物理参数

塑壳：LCP
接点：铜合金
电镀：
接触部位 - 镀金；
焊尾部位 - 镀镍后；
底层电镀 - 镀镍
工作温度：
Mirror Mezz、Mirror Mezz Pro：-40至+105摄氏度
Mirror Mezz Enhanced：-40至+85摄氏度

www.molex.com